國立勤益科技大學日間部四年制 112 學年度人工智慧應用工程系產學合作海外青年半導體製造實務技術專班學分計書表

National Chin-Yi University of Technology Curriculum for 2023 Four-Year Bachelor Program of Department of Artificial Intelligence and Computer Engineering

112. 08. 07 112 學年度第一學期第 1 次系課程通訊會議通過 112. 05. 04 系課程通訊會議通過 112. 05. 17 院課程會議審議通過 112. 06. 17 院課程會議審議通過 113. 07. 01 系課程會議審議通過 113. 09. 06. 系課程會議審議修訂通過 113. 11. 01. 11. 20. 院課程會議審議修訂通過 113. 11. 20. 院課程委員會議審議修訂通過 113. 11. 20. 院課程委員會議審議修訂通過 113. 12. 24. 教務會議審議修訂通過 113. 12. 24. 教務會議審議修訂通過

上學期 First Semester 下學期 Second Semester 實習 Internsh 科目 Courses 正課 正課 學分 學分 Internsh Lecture 共同必修科目(24 學分) General Required Courses (24 credits) 第一學年 First Year 華語聽說(一) Chinese Listening and Speaking (I) 0 Chinese Reading and Writing (I) 3 5 0 華語讀寫(一) Chinese Tutoring Courses 華語輔導課程 0 5 0 體育(一) Physical Education (I) 0 2 0 英文聽與說(一) English Listening and Speaking(I) 3 3 0 English Listening and Speaking(II) 英文聽與說(二) 華語聽說(二) Chinese Listening and Speaking (II) 3 5 0 Chinese Reading and Writing (II) 華語讀寫(二) 3 5 0 Physical Education (II) 2 體育(二) 0 0 0 藝術鑑賞 Art Appreciation 1 0 微積分 Calculus 第二學年 Second Year 華語聽說(三) Chinese Listening and Speaking (III) 第三學年 Third Year(無必修課程 No General Required Courses) 第四學年 Fourth Year(無必修課程 No General Required Courses) 專業必修科目(74 學分)Department Required Courses (74 credits) 第一學年 First Year 專業外語(一) Professional Foreign Language (I) 3 3 0 Interpersonal communication 0 人際溝通 工程實務訓練(一) Engineering Practical Training (I) 1 0 0 專業外語(二) Professional Foreign Language (I) 3 3 Labor Regulations 3 3 0 勞動法規 工程實務訓練(二) Engineering Practical Training (II) 1 0 第二學年 Second Year ●產業製造程序實習(一) • Industrial Manufacturing Program Internship (I) 0 3 6 ●產業生產設備實習(一) • Industrial Production Equipment Internship (I) 3 0 6 △程式設計 △ Programming 3 3 0 Computer Software Application and Design 電腦軟體應用與設計 ●產業製造程序實習(二) • Industrial Manufacturing Program Internship (II) 3 0 6 3 0 • Industrial Production Equipment Internship (II) 6 ●產業生產設備實習(二) •Introduction to Industry 4.0 3 2 ●工業 4.0 概論 1 2 △數位邏輯與實習 △Digital Logic and Experiment 3 1 基本電學 Basic Electricity 0 第三學年 Third Year ●產業製造程序實習(三) • Industrial Manufacturing Program Internship (III) 0 6 ●產業生產設備實習(三) • Industrial Production Equipment Internship (III) 3 0 6 Introduction to Semiconductor Components 3 半導體元件概論 0

第四學年 Fourth Year

3

3

3

2

2

2

1

1

3

3

3

2

3

0

計算機組織

資料結構(一)

資料結構(二)

△●資料庫管理系統實務

積體電路封測實務

積體電路製程實務

AI 機器學習

• Computer Organization

Data Structures(I)

Data Structures(II)

AI Machine Learning

△ Database Management System Practice

• Integrated Circuit Testing Practice

Integrated Circuit Processing

		上4	上學期 First Semester			下學期 Second Semester						
科目	Courses	學分 Credits	正裸 Lecture	責習 Internshi p	學分 Credits	正課 Lecture	實習 Internshi p					
共同選修科目 General Electives Courses												
	第一學年 First Year	ī	Ţ	ı	ı	ı						
全民國防教育軍事訓練(一)	All-Out Defense Education Military Training (I)	1	2	0								
全民國防教育軍事訓練(二)	All-Out Defense Education Military Training (II)				1	2	0					
第二學年 Second Year												
全民國防教育軍事訓練(三)	All-Out Defense Education Military Training (III)	1	2	0								
生活關懷實務	Life Care Practices	3	3	0								
全民國防教育軍事訓練(四)	All-Out Defense Education Military Training (IV)				1	2	0					
體育選修	第三學年 Third Year Physical Elective Course	1	2	0	1	2	0					
題月送修	第四學年 Fourth Year	1	2	U	1	2	U					
體育選修	Physical Elective Course	1	2	0	1	2	0					
7 T. 7 C. 19	專業選修科目 Department Elective	Courses	_		_	_	-					
	第二學年 Second Year											
AI智慧製造實務技術	AIIIntelligent Manufacturing Technology	3	2	1								
●積體電路封裝製程實務(一)	•Integrated Circuit Packaging and Testing Processes(I)	3	2	1								
●VLSI 概論	•Introduction to VLSI	3	3	0								
半導體產品概論	Introduction to Semiconductor Products	3	3	0								
•智慧機械概論	Introduction to Intelligent Machinery	3	2	1								
科技英文	English for Science and Technology	2	2	0								
●半導體製程概論	Introduction to Semiconductor Process				3	2	1					
電子電路概論	Introduction to Electronic Circuits				3	2	1					
電腦輔助繪圖	Computer Aided Drafting				3	2	1					
	第三學年 Third Year	T		T	T	1						
AI△●實務專題(I)	AI△ • Project Study(I)	3	2	1								
●智慧機械 APP 設計實務	Smart Machinery APP Design Practice	3	2	1								
機械與自動控制	Mechanical and automatic control	3	2	1								
●積體電路封裝製程實務(二)	• Integrated Circuit Packaging and Testing Processes(II)	3	2	1								
AI △●實務專題(Ⅱ)	Al△•Project Study(II)				3	2	1					
●智慧機械 SMB 實務	Smart Machinery SMB Practice				3	2	1					
覆晶技術製程實務	Flip chip technology process practice				3	2	1					
AOI 工程應用實務	AOI engineering application practice				3	2	1					
凸塊技術製程實務	Bump Technology Processing Practice				3	2	1					
生涯規劃	Career Planning				3	3	0					
●產業產品組裝實習(一)	•Industrial Product Assembly Internship (I)				6	0	12					
	第四學年 Fourth Year			1 .		I						
AI●產學合作專題(一)	Al University-Industry Collaboration (I)	3	2	1								
AI 機器人學	Al Robotics	3	2	1								
測試製程實務	Test Program Practice	3	2	1								
●封裝結構力學	Package Structural Mechanics The American	3	3	0								
科技報告寫作	Technical Report Writing	3	3	0								
●產業產品組裝實習(二)	Industrial Product Assembly Internship (II) All University Industria Callebration (II)	6	0	12	2	2	1					
AI●產學合作專題(二)	All University-Industry Collaboration (II)				3	2	1					
●積體電路封裝製程實務(三)	Integrated Circuit (IC) Packaging Process (III) Industrial Packaging Process				3	2	1					
●工業機械手臂實務 AT●AT 文 # 昨 田 # 改	Industrial Robotics Practice Allo Al Industry Application Practice				3	2	1					
AI•AI 產業應用實務	AI • AI Industry Application Practice				3	2	1					
半導體元件	Semiconductor Components				3	3	0					
●產業產品組裝實習(三)	●Industrial Product Assembly Internship (III)				6	0	12					

學分/時數統計 Credit/Hour Total	第一學年 First Year			第二學年 Second Year			第三學年 Third Year				第四學年 Fourth Year					
	上學期 First Semester		下學期 Second Semester I			上學期 下學期 First Semester Second Semester		上學期 First Semester		下學期 Second Semester		上學期 First Semester		下學期 Second Semester		
	學分 Credit	學時 Hour	學分 Credit	學時 Hour	學分 Credit	學時 Hour	學分 Credit	學時 Hour	學分 Credit	學時 Hour	學分 Credit	學時 Hour	學分 Credit	學時 Hour	學分 Credit	學時 Hour
必修科目學分/時數 Required Courses Credit/Hour	16	27	19	25	15	21	15	21	15	21	9	9	3	3	6	6
最低選修科目學分/時數 Minimum Electives Courses Credit/Hour	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6	12	12	18	9	15
總學分數/時數累計 Credits/Hours Total	16	27	22	28	15	21	15	21	15	21	15	21	15	21	15	21

At least 128 credits should be completed for graduation [98 credits of required courses and at least 30 credits of electives (including at least 30 credits of electives required for the major of the department)].

^{1.} 畢業至少應修滿128學分【必修98學分,選修至少30學分(其中至少需含本系專業選修科目30學分)】。

^{2.} 課程名稱前有標示「●」符號者,為「職能專業課程」。 Courses with a "●" refer to a professional competence course.

3.課程名稱前有標示「△」符號者,為程式設計課程。 Courses with a "△" refers to an application design course. 4.課程名稱前有標示「AI」符號者,為「人工智慧相關課程」。

Courses with an "AI" refer to an artificial intelligence related course.

5.為因應法規變更、評鑑建議或政府計畫規定等外在因素,本系保有調整學分計畫之權利。若有修訂,將於學期開始前公告, 並明確說明修訂內容、影響範圍及相關配套措施,以保障學生權益。

The department reserves the right to adjust the curriculum in response to external factors such as changes in regulations, suggestions of evaluation and accreditation, or government program regulations. If there are any revisions, will be announced before the start of the semester, and the revised content, scope of impact, and related supporting measures will be clearly stated to protect the rights and interests of students.